

2007年度新規参入業者

光電業者

生耀光電株式会社

認可投資金額20.4億円、太陽エネルギー発電モジュール開発。

高治達科技株式会社

認可投資金額6.8億円、拡散片および反射片開発。

湛康材料科技株式会社

認可投資金額2億円、電子産業用光阻剤材料・電子産業用顕影液材料・電子級溶剤材料開発。

多摩光電株式会社南科支社

認可投資金額18.8億円、背光モジュール開発。

大億光能株式会社

認可投資金額68億円、フィルム太陽エネルギー電池およびモジュールの開発およびこれらの製品に関連する技術サービス。

晶発光電株式会社

認可投資金額54.4億円、高亮度・高機能発光二極体エピウエハチップ(EPI wafer CHIP)および晶粒の開発。

宇通光能株式会社

認可投資金額47.6億円、シリコンフィルム太陽エネルギー電池およびモジュールの開発。

緑陽光電株式会社

認可投資金額14億円、フィルム太陽エネルギー電池および関連モジュールの開発。

興南科技株式会社

認可投資金額2.4億円、透明導電薄膜(Indium Tin Oxide, ITO films)の開発。

福聚太陽エネルギー株式会社

認可投資金額215億円、ポリシリコン(polysilicon)の開発。

バイオテクノロジー業者

熒茂光学株式会社

認可投資金額11.9億円、光学ガラスの開発。

医百科技株式会社

認可投資金額1.2億円、歯科臨床技術評価および審査導引システムと関連パーツの開発。

藍海科技株式会社

認可投資金額1.2億円、生医級sintered-hydroxyapatite powder (HA powder)・HA粉末焼結体および関連応用製品の開発。

鴻君科技株式会社

認可投資金額3.4億円、インプラントおよび関連器材の開発。

精密機械業者

台湾普熙株式会社

認可投資金額0.7億円、真空設備システムおよびその関連パーツの開発。

程裕機械株式会社南科支社

認可投資金額0.9億円、工業ロボット設備とその関連設備の開発。

勤友科技株式会社

認可投資金額8.5億円、連続式スパッタリング装置(Sputtering System)設備の開発。

弘邦精密株式会社

認可投資金額3.4億円、CVDダイヤモンド厚膜関連製品・ダイヤモンド散熱モジュール関連製品およびシーブイディー生医関連製品の開発。

通信業者

大同電信株式会社南科支社

認可投資金額1.7億円、WiMAX無線LANターミナル接続応用装置の開発。

その他業者

瑞研材料科技株式会社

認可投資金額1億円、ナノ複合材料・ナノ混成材料の開発および関連技術サービス。

台京企業股份有限公司高雄園區支社

認可投資金額6.5億円、クロムレス(Chromeless)塗料とその応用製品・マイクロプラズマ酸化(Micro Plasma Oxidation;MPO)表面処理技術とその応用製品の開発。